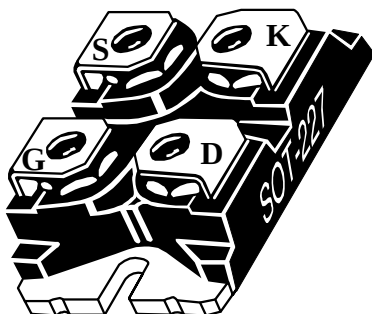
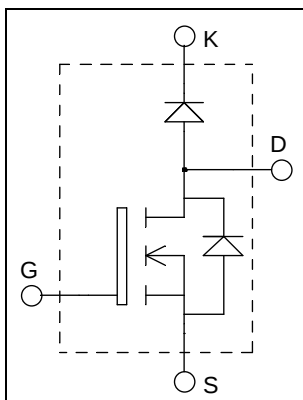


ISOTOP® Boost chopper MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 500V$

$R_{DSon} = 65m\Omega \text{ Max @ } T_j = 25^\circ C$

$I_D = 58A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$



Application

- AC and DC motor control
- Switched Mode Power Supplies
- Power Factor Correction
- Brake switch

Features

- Power MOS 8™ MOSFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- ISOTOP® Package (SOT-227)
- Very low stray inductance
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Stable temperature behavior
- Very rugged
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Easy paralleling due to positive TC of V_{CEsat}
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	500	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	A
		$T_c = 80^\circ C$	
I_{DM}	Pulsed Drain current	270	
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	65	$m\Omega$
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	W
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	42	A



CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 500\text{V}$ $V_{GS} = 0\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 42\text{A}$			65	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 2.5\text{mA}$	3	4	5	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}$			± 100	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$		10800		pF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$		1164		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		148		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$		340		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge	$V_{Bus} = 250\text{V}$		75		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge	$I_D = 42\text{A}$		155		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Resistive switching @ 25°C $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 42\text{A}$ $R_G = 2.2\Omega$		60		ns
T_r	Rise Time			70		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			155		
T_f	Fall Time			50		

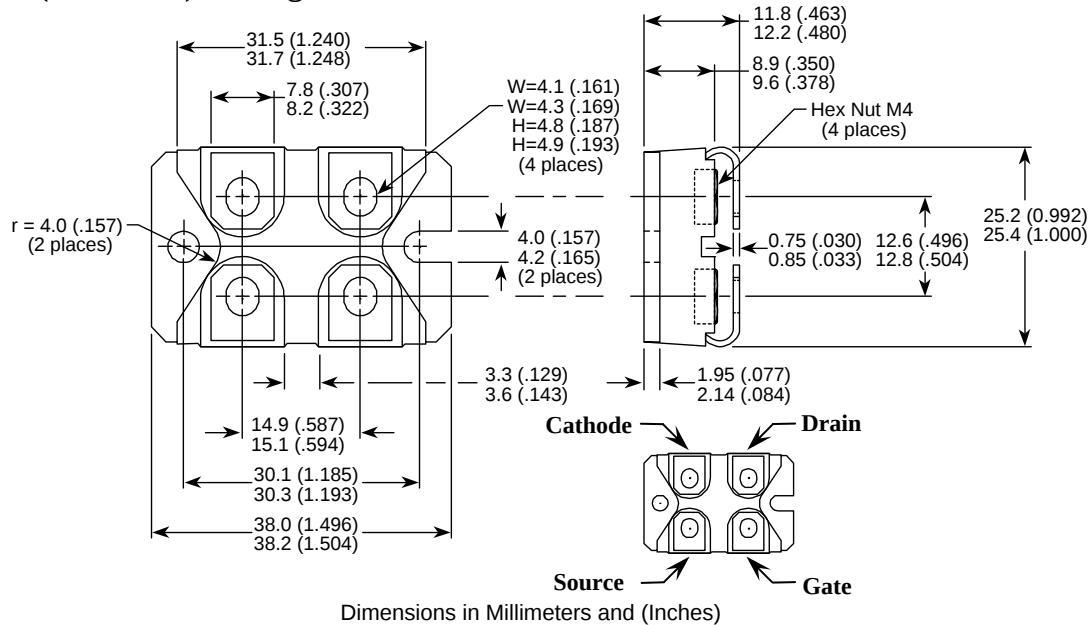
Chopper diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		600			V
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		25	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		500	
I_F	DC Forward Current	$T_c = 90^\circ\text{C}$		30		A
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 30\text{A}$		1.8	2.2	V
		$I_F = 60\text{A}$		2.2		
		$I_F = 30\text{A}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$		1.5		
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 30\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	25		ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	160		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$T_j = 25^\circ\text{C}$		35		nC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	480		

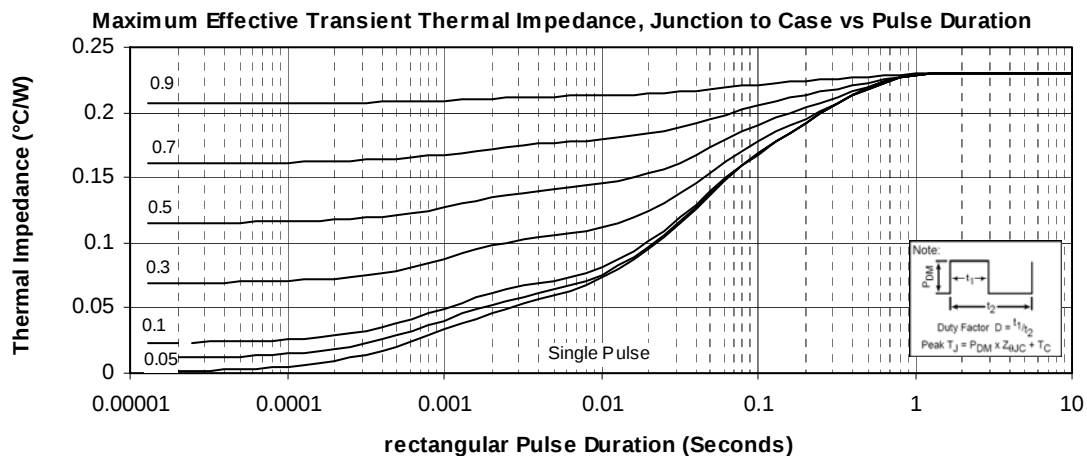
Thermal and package characteristics

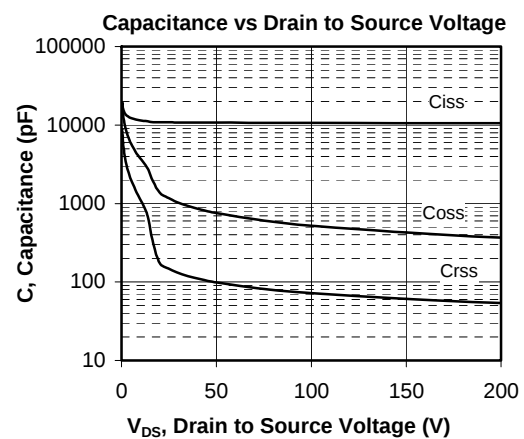
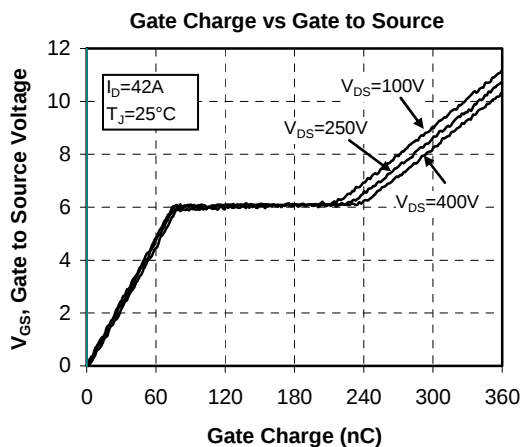
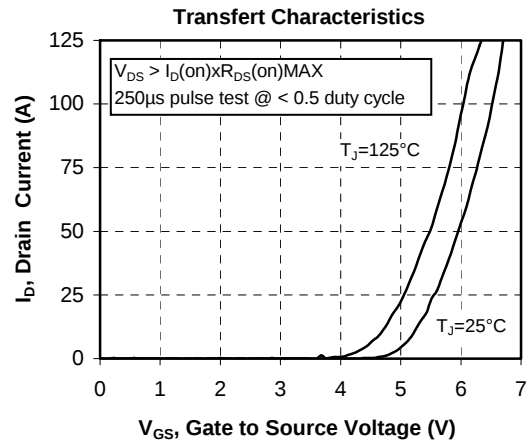
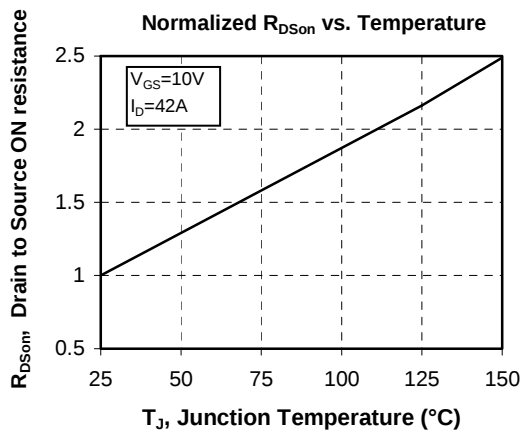
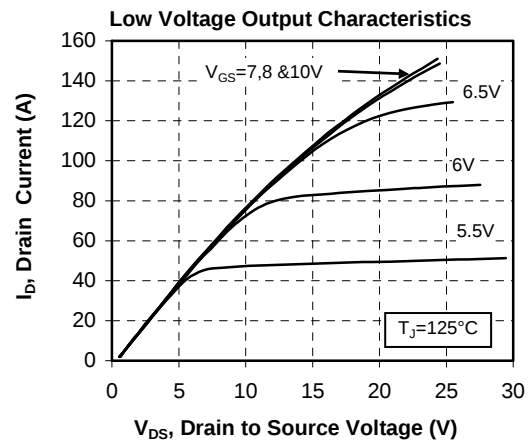
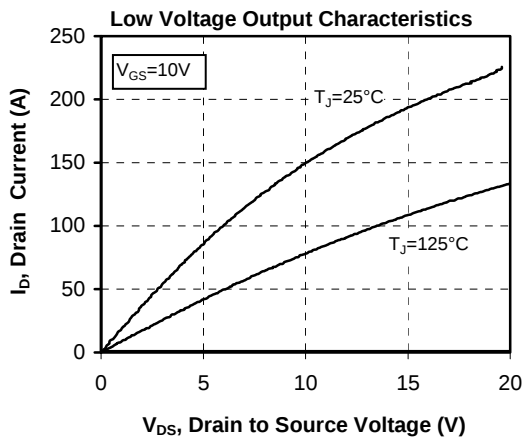
Symbol	Characteristic		Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance	Mosfet			0.23	$^\circ\text{C}/\text{W}$
		Diode			1.05	
R_{thJA}	Junction to Ambient (IGBT & Diode)				20	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}$, $I_{isol} < 1\text{mA}$, 50/60Hz		2500			V
T_j, T_{STG}	Storage Temperature Range		-40		150	$^\circ\text{C}$
T_L	Max Lead Temp for Soldering: 0.063" from case for 10 sec				300	
Torque	Mounting torque (Mounting = 8-32 or 4mm Machine and terminals = 4mm Machine)				1.5	N.m
Wt	Package Weight			29.2		g

SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline

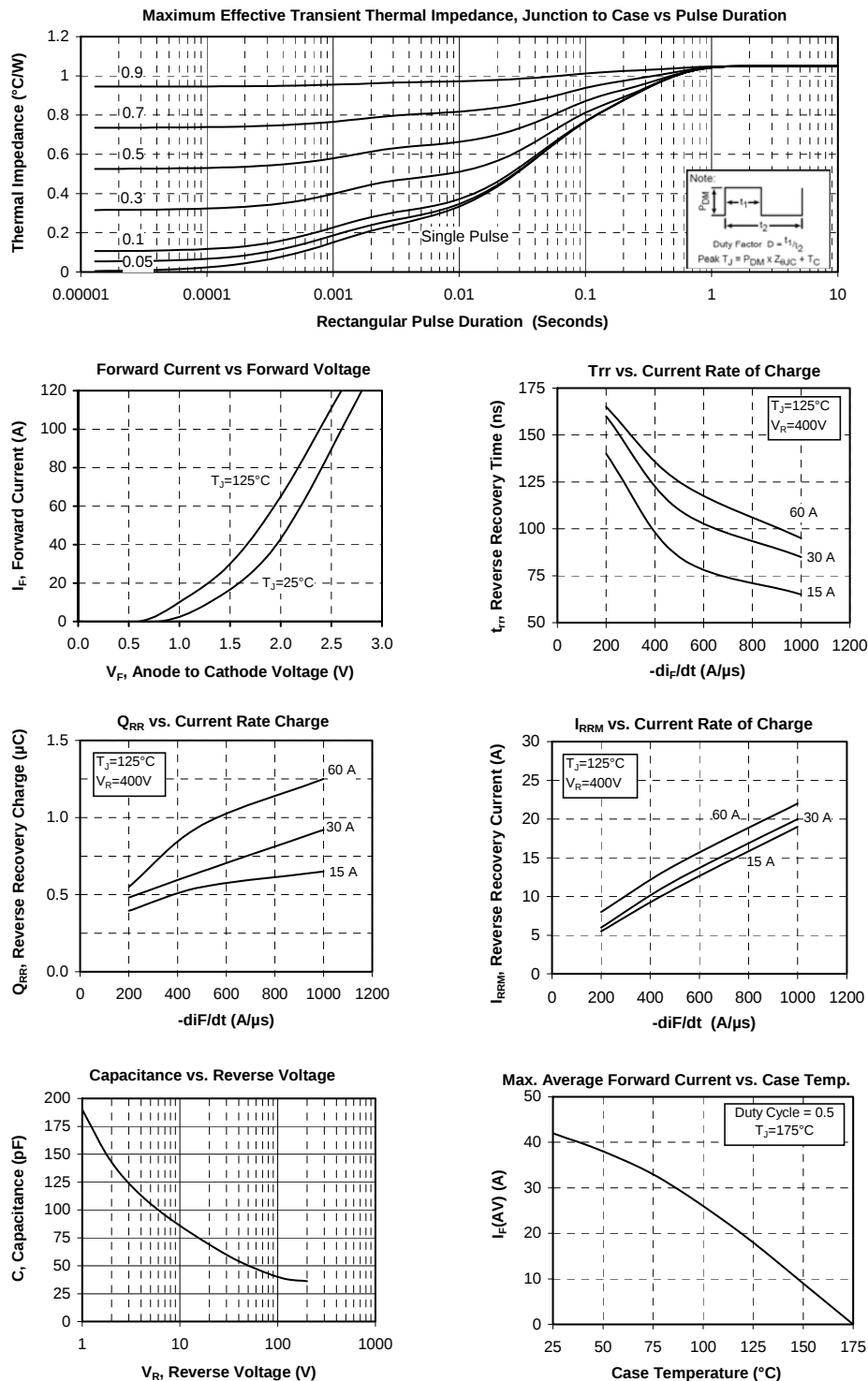


Typical Mosfet Performance Curve





Typical Diode Performance Curve



ISOTOP® is a registered trademark of ST Microelectronics NV

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9